

证券代码：688469

证券简称：芯联集成

芯联集成电路制造股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中信证券、长江证券、华创证券、平安证券、申万菱信、富国基金、鹏华基金、华夏基金、信达资本、JP MORGAN、UBS等百余家机构
时间	2025年2月17日 20:00-21:00
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：赵奇 财务负责人：王伟 副总经理：张霞 董事会秘书：张毅 芯联动力董事长：袁锋
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司管理层介绍相关情况</p> <p>公司通过与业界头部客户全面和深入合作的市场策略，不断提升公司技术的先进性，已成长为新能源、智能化产业核心芯片的支柱性力量。</p> <p>公司采用一站式芯片代工的商业模式，从横向维度覆盖从设计服务、晶圆制造、模组封装、应用验证到可靠性测试；从纵向维度满足包括功率器件、功率IC、MCU、模组在内的由点到面的代工需求。以车规级大型生产基地为基础，搭建特色化工艺平台并配套提供基础IP库，助力客户的芯片开发及制造，持续迭代工艺平台，保证技术与工艺的先进性和实用性。</p> <p>坚持技术+市场双轮驱动，在成立后第一个五年，公司已成为国内最大IGBT代工基地、最大MEMS代工基地，SiC MOSFET技术达到国际领先水</p>

平。后续公司将重点布局模拟IC、MCU和系统代工，在业务路径上实现从晶圆代工到产品级的代工，最终实现系统代工，致力于成为中国最大的模拟芯片研发和生产基地。

公司下游应用主要覆盖车载、AI、消费、工控四大领域，目前重点布局新能源和AI人工智能两大应用方向。如在车载业务上，公司目前可配套的汽车芯片以功率芯片及模组、传感类为主，预计随着公司业务的不展，将逐步覆盖模拟类芯片、MCU芯片。除了电动化，自动驾驶驱动车载MEMS需求增长，传感器及激光雷达已经实现量产，公司在智驾领域的芯片应用也持续增加，与头部客户进入更深度的合作。

公司坚持市场+技术双轮驱动，打造全球领先的数模混合系统代工平台。2025年，公司将紧抓AI智能时代机遇，持续技术创新，在模拟IC、功率模块、以及SiC MOSFET、MEMS等新增长点的带动下，迈入新一轮高增长阶段。

二、交流环节

1、汽车业务是公司收入的主要应用方向，在智能驾驶相关业务，公司有哪些布局？各车企均发布了智驾战略，预计智驾将加速普及，公司对应的业务增长情况如何？

智能化是新能源车行业发展的下半场，公司已做好全面布局，部分产品已经率先实现了突破和量产。智驾技术正在经历技术迭代与产业升级的双重驱动，将直接拉动模拟芯片、功率、MCU芯片的增量需求。

对模拟芯片来说，传感器驱动着对模拟芯片需求的增长。任何一家的智驾系统，都依赖多传感器的融合方案，包括毫米波雷达、激光雷达、摄像头等，这直接推动了对高精度模拟芯片的需求。例如在感知层，大量传感器均需配套模拟前端芯片（AFE）、信号调理芯片等，用于信号采集、滤波和模数转换。同时，智驾系统中激光雷达被广泛采用。公司的VCSEL、MEMS振镜、BCD工艺为基础的驱动芯片等，均为激光雷达的核心芯片。

对功率芯片来说，电动化与智能化需要协同升级。智驾系统的能耗管理对电源管理和功率芯片提出更高的要求，在协同升级中，除了对量的需求之外，进一步提高的技术门槛还会促使供应端的进一步集中化。

对MCU芯片来说，这是智驾系统中控制层与执行层的核心载体，MCU芯片在新一代智驾架构中不可或缺。安全相关的执行层控制，依赖于高实时性高安全的MCU芯片，同时，末端电机和车灯等周边模拟芯片和MCU的进一步融合，单片集成趋势大大加强。公司提供的高压模拟嵌入高可靠性控制

单元的技术平台，具有广阔的市场需求，将成为重要增长点。

国产化率带来更多机遇。除去小功率硅基MOS芯片国产化率已经较高外，车载芯片目前实际的国产化率还不及10%。国产芯片具有巨大的可替代空间。中国新能源车产业，在规模扩大的同时提出了全新的电气电子架构和芯片定义需求。车载国产化已经进入2.0时代，在提高国产化率的同时，中国芯片产业也需要配合终端从底层硬件上的协同创新。另外，近期看到国外汽车厂商也纷纷在中国建立供应链，用性价比更好的中国芯片支持全球汽车产业的发展。

公司在汽车客户上覆盖广泛，汽车的智能化对公司多个产品线带来多重机遇，包括功率、VCSEL、MEMS、BCD工艺平台、MCU等产品。

2. 公司在AI服务器电源、机器人等领域，积极进行AI业务布局，公司在这些业务上有哪些重点突破或重大进展？未来的增长趋势和对公司的营收贡献情况如何？

公司在功率芯片、模拟芯片和MCU芯片上的全面布局，将会对以AI服务器为代表的新型电源需求形成全面的支撑。

公司在AI服务器电源作了全面布局：以GaN和SiC为主的高频功率芯片及配套的BCD驱动芯片、以DrMOS为标志的融合型模拟电源IC芯片，是公司AI领域的两条主线。前者将实现全系列芯片的大规模量产，后者已经率先实现单点突破。Deepseek将会大大加速中国AI产业化时代的到来，公司将向行业提供全面国产化的AI服务器电源方案，产品可覆盖AI服务器电源总价值的50%以上。

同时，公司在AI末端应用上提供高性能功率芯片和多品种智能传感器芯片。我们已经有机人灵巧手的芯片订单，后续还将持续扩大公司为机器人新系统提供电源、电驱、传感器等各种芯片。

3. 公司对SiC业务进展及对竞争格局的看法？

2024年公司在SiC业务上实现了10亿元以上的营收，预计2025年还将继续保持高增长。SiC业务继续保持高增长，是基于公司SiC业务方面产品量产、客户定点的持续增加，技术优势和规模经济效应显著。

市场方面，SiC产业链价格的持续优化，主要是SiC衬底技术不断成熟、良率上升带来的。器件生产的价格还是相对稳定的。当然，从长期来看，价格下降符合工业生产趋势，也符合SiC要进一步提升应用渗透率的需求。预计在6英寸转8英寸后，SiC产品会更具性价比。

公司在设备、技术方面布局更早，能够在这一趋势中把握先发优势，

	<p>维持利润水平、提升市占率。同时，也将通过技术创新、高效的供应链管理、6英寸转8英寸的先发优势等，保持良好的产品竞争力。</p> <p>4. 2025年的资本开支情况，主要在哪些项目上？对公司今年如何展望？</p> <p>根据市场的需求情况，公司2025年的资本开支主要用于模拟IC增产，SiC产品8英寸产能转化，和模块业务增产上。</p> <p>2025年公司营收增速将继续保持快速增长。随着收入规模增长和折旧压力的稳步下降，公司毛利率稳步提升，净利润也会取得明显突破，从而争取2026年实现全面、有厚度的盈利转正。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2025年2月17日</p>